

Willkommen bei O-Leading

Wir sind ein professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Produktpalette: einseitige, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir können einen Rapid Prototyping-Service anbieten: S / S in 24 Stunden, 4-8 Einheiten in 48-96 Produktionsstunden.

MINDESTKUPFERPLATTENLÖCHER .025 AVG, .020 MIN .. LÖCHER KÖNNEN NICHT VERBUNDEN WERDEN

Verpackt mit klarem, blasenlosem Film, 25 Stück / Beutel, legen Sie das Trockenmittel auf die Seite und legen Sie den Feuchtigkeitsindikator darauf

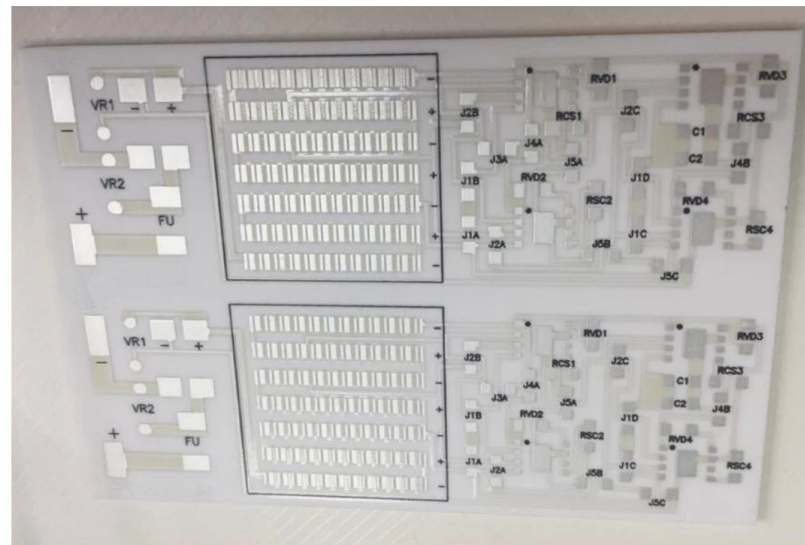
KLICKEN SIE HIER FÜR WEITERE INFORMATIONEN: [Dickschicht-Leiterplattenhersteller](#)

Produktbeschreibung

- [Lieferant von Keramik-Leiterplatten](#)

PCB P / N.	Q503701-A
Schichten zählen	2L
Material	B.ASE Keramik
Der Aufsichtsrat	0,55 mm
Kupfer thk	1/1 oz
Kleinste Lochgröße	1.6mm
Anzahl der Löcher (Stücke)	4
Linie w / s	/.
Impedanzprüfung S / N (Tol%)	N.
Oberflächenfinish	Elektrisches Silber
Siebdruckschweißmaske	Grün
Einfache Abmessungen	Dim X (mm): 109; Dim Y (mm): 50
Panelisierung	Dim X (mm): 109; Dim Y (mm): 50; UPS Nr.: 1
Besonderheit: abziehbare Maske	N.
Routing / Stanzen	CNC

•



www.o-leading.com

Aluminiumoxid Keramiks substrat PCB China

Unser Team





Zertifizierungen



201726 201VZL430354 - Wiring, Printed - Component



ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [ULi Family of Databases](#).
Click on a product designation for complete information.

Page Bottom

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED 4190354

Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

	Cond Width			SS/ DS/ Diam	Area	Solder		Temp		Flame	RoHS	C
	Min	Max	Min			Max	Class	DSR				
Typ	max(in)	mm(in)	mic(mil)	DSO	mm ² (in ²)	C	sec	C	Class	DSR	I	
Multi-layer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-	
O-LEADING-407												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	170	V-0	NI	-	
Multi-layer printed wiring boards.												
O-LEADING-408												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) min:1.25	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	NI	*	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002												
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI	-	
O-LEADING-003												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-	
O-LEADING-033												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI	-	
O-LEADING-205												
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	
O-LEADING-206												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.
Last updated on 2017-01-27

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

http://www.ul.com/ulcertification/UL60718RMS/ewg/ul/Prod/ZPMV2.E490354/cond/Wiring,Printed-Component/10



Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce the launch of its new RoHS testing service. This service is designed to meet the needs of manufacturers and suppliers who are looking for a reliable and cost-effective way to ensure their products are RoHS compliant. The service is available in a number of locations and is designed to be a simple and straightforward process. For more information, please contact your local SGS office or visit our website at www.sgsgroup.com.

Member of the SGS Group (SGL SA)

Verpackung & Lieferung

Verpackung Einzelheiten	Professioneller Hersteller von Leiterplatten seit 16 Jahren
Lieferdetail	7-12 Tage



FAQ

1. Wie garantiert O-Leading Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit folgenden erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach den Normen ISO 9001: 2008 kontrolliert.
2. Umfangreicher Einsatz von Software bei der Verwaltung des Produktionsprozesses
3. modernste Testwerkzeuge und Werkzeuge. Zum Beispiel. Fliegende Sonde, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (Schaltungstest).
4. Qualitätssicherungsteam, das mit dem Fehlerfallanalyseprozess spezifiziert wurde
5. Personalschulung und kontinuierliche Weiterbildung

2. Wie hält O-Leading den wettbewerbsfähigen Preis aufrecht?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise für viele Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Die chinesische Währung RMB legte gegenüber dem US-Dollar um 31% zu; Auch unsere Arbeitskosten sind deutlich gestiegen. O-Leading hat unsere Preise jedoch konstant gehalten. Es geht um unsere Innovationen, um Kosten zu senken, Abfall zu vermeiden und die Effizienz zu verbessern. Unsere Preise sind in der Branche bei gleichem Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Partnerschaft zum gegenseitigen Nutzen mit unseren Kunden. Unsere

Partnerschaft ist für beide Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Kosten- und Qualitätsvorteil bieten können.

3. Welche Arten von Karten kann der O-Leading-Prozess herstellen?

FR4-Platten mit hohem TG und hohem Halogengehalt, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupfer-Platten, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenherstellung benötigt?

Es ist besser, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können auch Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Schnittmaterial → innerer Trockenfilm → Innengravur → Innen-AOI → Mehrfachbindung → überlappende Pressschichten → Bohren → PTH → Beschichtung → Außen-Trockenfilm → Beschichtung → Außengravur → AOI → Außenschweißmaske → Nachnahmekomponente → Endbearbeitungsfläche → Fräsen → E / T → Sichtprüfung.